

Ley Europea de Chips: Seguridad del suministro y resiliencia

El pilar II de la Ley Europea de Chips establece un marco para garantizar la seguridad del suministro y la resiliencia del sector de los semiconductores de la Unión atrayendo inversiones y mejorando las capacidades de producción en la fabricación, el envasado avanzado, los ensayos y el montaje.

Panorama general de los principales elementos del pilar II



Situación de la instalación de producción integrada y de la fundición abierta de la UE

- Características de las FIP y la HAO
- [Aplicación y orientación \(https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/european-chips-act-commission-publishes-guidance-application-process-status-integrated-production\)](https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/european-chips-act-commission-publishes-guidance-application-process-status-integrated-production)
- Beneficios y obligaciones



Etiqueta del centro de diseño de excelencia

- Características de los centros de diseño de excelencia
- Requisitos y aplicación de la etiqueta

Situación de la instalación de producción integrada y de la fundición abierta de la UE

Las instalaciones «primeras en su clase» son instalaciones de fabricación de semiconductores nuevas o sustancialmente mejoradas que proporcionan una dimensión de innovación que aún no está presente en la UE. Estas instalaciones pueden solicitar el estatuto de «instalación de producción integrada» (IPF) o «fundición abierta de la UE» (OEF).

- Las instalaciones de producción integradas son instalaciones de fabricación de semiconductores integradas verticalmente, que participan en la fabricación front-end, en la producción de equipos o componentes clave para dichos equipos utilizados predominantemente en la fabricación de semiconductores en la Unión, así como en el diseño de circuitos integrados o la prestación de servicios back-end, o ambos.
- Las fundiciones abiertas de la UE son instalaciones de fabricación de semiconductores que dedican al menos una cierta parte de su capacidad de producción a producir chips de acuerdo con el diseño de otras empresas, en particular empresas de fábulas.



La condición de CIP o HAO da derecho a las empresas a un enfoque racionalizado de las solicitudes administrativas y a un acceso prioritario a las líneas piloto establecidas en el marco de la «Iniciativa [Chips para Europa](https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/factpages/chips-europe-initiative)» (<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/factpages/chips-europe-initiative>) (pilar I). Además, si bien la solicitud de la condición de CIP o HAO es un procedimiento separado de la evaluación de las ayudas estatales de primera clase, cuando es posible, estos dos procedimientos y las evaluaciones respectivas se llevan a cabo en paralelo.

En la fase de crisis, la Comisión, previa consulta al [Consejo Europeo de Semiconductores](https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/factpages/chips-act-monitoring), (<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/factpages/chips-act-monitoring>) puede pedir a las empresas a las que se haya concedido el estatuto de CIP o HAO que den prioridad a un pedido de productos pertinentes para la crisis (pedido calificado como prioritario).

Para navegar mejor por el proceso de solicitud, comprender los criterios de admisibilidad y preparar los documentos justificativos, consulte también las [orientaciones](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AC_202404911) (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AC_202404911) elaboradas por la Comisión para la aplicación de los compromisos.

Etiqueta de centros de diseño de excelencia

La Comisión podrá conceder una etiqueta de «centro de excelencia en materia de diseño» a los centros de diseño establecidos en la Unión que mejoren significativamente las capacidades de la Unión en materia de diseño innovador de chips a través de sus ofertas de servicios o mediante el desarrollo, la promoción y el refuerzo de las capacidades y competencias de diseño.

El procedimiento para las solicitudes y los requisitos y condiciones para la concesión, el seguimiento y la retirada de la etiqueta serán establecidos por la Comisión mediante actos delegados.



Contenido principal de la Ley de Chips



European Chips Act (<https://digital-strategy.ec.europa.eu/es/policies/european-chips-act>)

The European Chips Act will boost Europe's technological sovereignty, competitiveness, resilience and contribute to the digital and green transitions.

Esto es una traducción automática facilitada por el servicio eTranslation de la Comisión Europea para ayudarle a comprender esta página. [Por favor, lea las condiciones de uso](https://ec.europa.eu/info/use-machine-translation-europa-exclusion-liability_en) (https://ec.europa.eu/info/use-machine-translation-europa-exclusion-liability_en). Para leer la versión original, [acceda a la página fuente](https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/factpages/european-chips-act-security-supply-and-resilience) (<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/factpages/european-chips-act-security-supply-and-resilience>).

PDF generated on 05/04/2025 from [Ley Europea de Chips: Seguridad del suministro y resiliencia](https://digital-strategy.ec.europa.eu/es/factpages/european-chips-act-security-supply-and-resilience) (<https://digital-strategy.ec.europa.eu/es/factpages/european-chips-act-security-supply-and-resilience>)

© Unión Europea, 2025 - Reuse of this document is allowed, provided appropriate credit is given and any changes are indicated (Creative Commons Attribution 4.0 International license). For any use or reproduction of elements that are not owned by the EU, permission may need to be sought directly from the respective right holders.

Fotografía 1 © aicandy - Adobe Stock Picture 2 © gorodenkoff - Adobe Stock